



北京某大学新型存储器评估项目

编制单位：北京尚普华泰咨询有限公司

联系电话：010-82885739

邮编：100080 邮箱：hfchen@shangpu-china.com

北京总公司：北京市海淀区苏州街3号大恒科技大厦6层

网址：<https://www.sunpul.cn>

第一章 项目及团队概况

1.1 项目概况

1.1.1 项目名称

北京某大学新型存储器评估项目

1.1.2 项目核心技术及优势

随着集成电路的发展，器件尺寸越来越小，集成密度越来越高。同时随着移动互联网的发展，对于移动端设备的器件功耗要求越来越高。对于非易失存储器来说，主流闪存（Flash）性能难以满足未来移动互联网的发展需求，ReRAM 等新型存储器具有集成度高、功耗低、读写速度快等优势，使之成为下一代存储器的有力竞争者。

大学团队在国内（大陆）最早开展钽基阻变存储器（ReRAM）研究，经过多年与国内头部代工厂的联合攻关，构建了“材料-器件-工艺-电路-算法”全链条自主可控技术体系和知识产权矩阵。团队研制的 ReRAM 技术在集成密度和可靠性方面达到了国际领先，有望为下一代高端存储芯片和人工智能芯片等战略领域提供颠覆性底层支撑。

1.1.3 项目产品

1.2 团队概况

1.2.1 ***教授

1.2.2 其他核心人员

1.2.3 团队成就

1.3 项目编制原则、依据及范围

1.3.1 编制原则

1、项目实施必须遵循国家的各项政策、法规和法令，符合国家产业政策、投资方向及行业和地区的规划。

2、以科学、实事求是的态度，公正、客观地反映本项目实施的实际情况，

坚持“求是、客观”的原则。

3、通过对市场的分析研究以及对项目规划的研究，论证项目实施的合理性。

1.3.2 编制依据

- 1.《产业结构调整指导目录（2024 年本）》；
- 2.《信息化标准建设行动计划（2024-2027 年）》；
- 3.《关于推动未来产业创新发展的实施意见》；
- 4.《国家汽车芯片标准体系建设指南》；
- 5.....；
- 6.《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）；
- 7.《投资项目可行性研究指南》；
- 8.由国家颁布的建设项目可行性研究及经济评价的有关规定；
- 9.业主提供的相关数据、资料；
- 10.其他相关法律法规、规范及标准。

1.3.3 研究范围

本报告预测了本项目知识产权相关的新型存储器市场未来的市场规模，通过本报告预测和详细测算，为项目投资决策提供定量分析参考依据。

本报告根据国家对实施项目可行性研究报告编制的工作范围和深度规定，对项目实施的依据、条件及背景进行了论述，对市场的需求进行了分析和预测，对项目技术先进性、项目技术产生的经济和社会效益等方面进行综合性分析和评价，为项目决策提供可靠、科学的依据。

第二章 项目所处宏观背景分析

2.1 政策背景

数据存储是信息产业的重要环节，存储器是数据存储的重要载体之一。随着我国进入加快数字化发展、建设数字中国的新阶段，国家和地方政策大力支持存储芯片行业发展，我国存储器产业发展环境进一步优化，产业创新能力和发展质量进一步提升。

图表 2：我国新型存储器部分相关政策列表

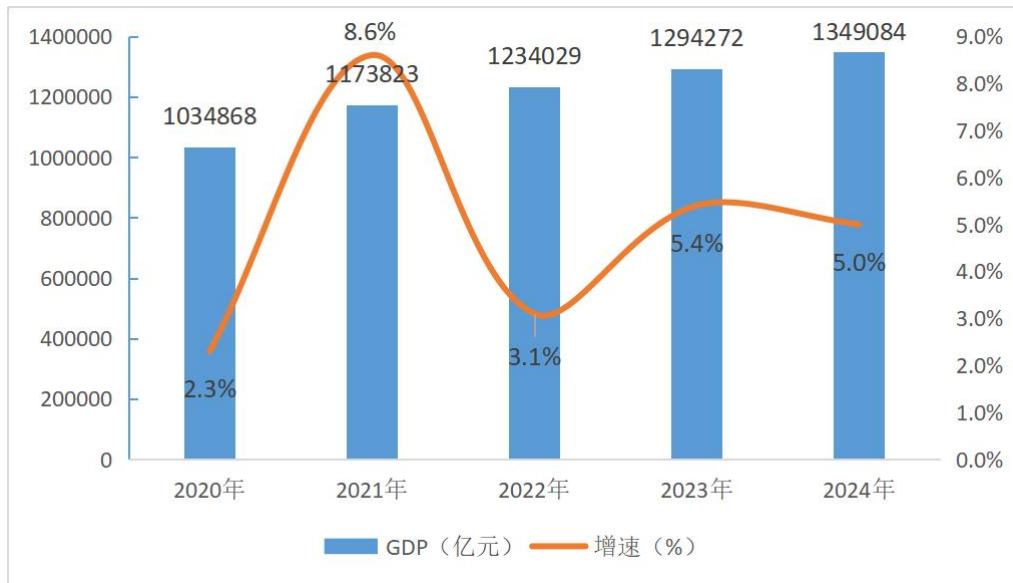
发布时间	政策名称	发布机构	主要内容
2024年5月	《信息化标准建设行动计划（2024-2027年）》	中央网信办、市场监管总局、工业和信息化部	围绕集成电路关键领域，加大先进计算芯片、新型存储芯片关键技术标准攻关，推进人工智能芯片、车用芯片、消费电子用芯片等应用标准研制。
2024年1月	《关于推动未来产业创新发展的实施意见》	工业和信息化部、教育部、科技部等七部门	加速类脑智能、群体智能、大模型等深度赋能，加速培育智能产业；深入推进5G、算力基础设施、工业互联网、物联网、车联网、千兆光网等建设，构建高速泛在、集成互联、智能绿色、安全高效的新型数字基础设施。引导重大科技基础设施服务未来产业，深化设施、设备和数据共享，加速前沿技术转化应用。
2023年12月	《国家汽车芯片标准体系建设指南》	《国家汽车芯片标准体系建设指南》	发挥标准在技术创新、成果转化、整体竞争力提升等方面的引导作用，以产业创新发展需求为导向，充分融合汽车和集成电路行业在技术研发、产业化发展和市场推广等方面优势，加强行业统筹协调，推动汽车芯片产业健康可持续发展。
2023年8月	《电子信息制造业2023-2024年稳增长行动方案》	工业和信息化部、财政部	提升产业链现代化水平。聚焦集成电路、新型显示、服务器、光伏等领域，推动短板产业补链、优势产业延链、传统产业升链、新兴产业建链，促进产业链上中下游融通创新、贯通发展，全面提升产业链供应链稳定性。
.....			

2.2 经济背景

2.2.1 国民经济回升向好，高质量发展扎实推进

初步核算，2024 年国内生产总值 1349084 亿元，比上年增长 5.0%。其中，第一产业增加值 91414 亿元，比上年增长 3.5%；第二产业增加值 492087 亿元，增长 5.3%；第三产业增加值 765583 亿元，增长 5.0%。第一产业增加值占国内生产总值比重为 6.8%，第二产业增加值比重为 36.5%，第三产业增加值比重为 56.7%。

图表 3：2020-2024 年我国生产总值及其增长速度



数据来源：国家统计局

2.2.2 人工智能产业发展迅猛

人工智能浪潮席卷全球，正以前所未有的速度、广度和深度改变生产生活方式，世界主要国家纷纷将推进人工智能技术创新与应用作为国家战略的重要方向。人工智能产业涵盖广泛，包括大数据、云计算、物联网、5G 技术、智能机器人、计算机视觉、自动驾驶等领域。近年来，大模型涌现式发展和生成式人工智能技术加速产业化进程，为人工智能产业高速增长提供了核心动力。据 IDC 预测，2024 年全球人工智能产业规模将达到 6233 亿美元，同比增长 21.5%。

图表 4：2021-2025 年全球人工智能产业规模



数据来源：IDC

受益于国家政策的支持，以及资本和人才的驱动，我国人工智能产业蓬勃发展，已步入世界前列。根据中国信通院数据，.....。

图表 5：2019-2030 年我国人工智能产业规模及预测情况



数据来源：中国信通院

2.2.3 数据产生量和存储量持续增长

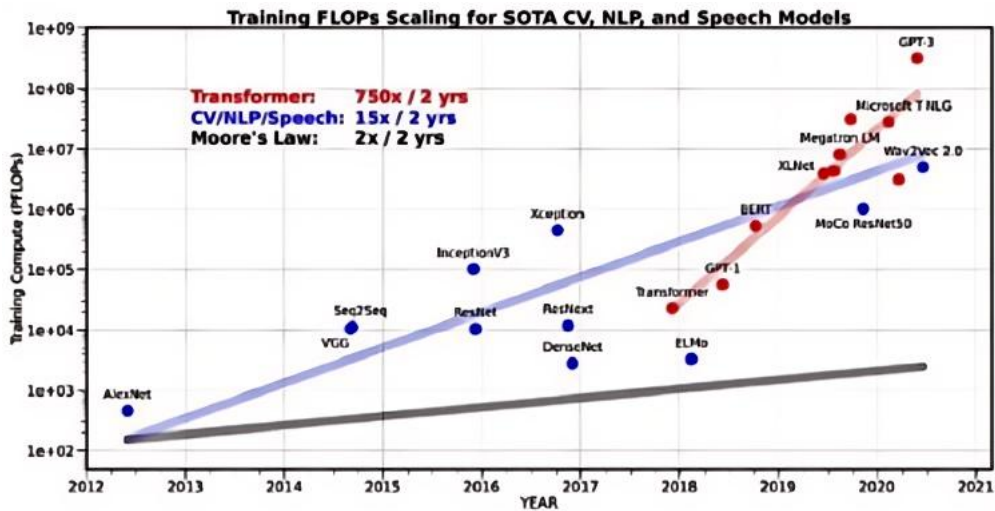
.....。

2.3 技术背景

2.3.1 AI 大模型参数量及训练数据量呈指数级增长

当前，全球 AIGC 行业进入高速发展期，AI 大模型性能持续提升的背后是千亿级以上的参数训练。根据 OpenAI 官网，AI 模型训练计算量自 2012 年起每 3、4 个月就增长一倍。从 GPT-1 到 GPT-3，模型参数量从 GPT 的 1.17 亿增加到 GPT-2 的 15 亿，再到 GPT-3 的 1750 亿；训练数据量也由 GPT 的 5GB，增加到 GPT-2 的 40GB，再到 GPT-3 的 45TB。高速增长 AIGC 行业对算力、存储等基础设施提出了新需求。

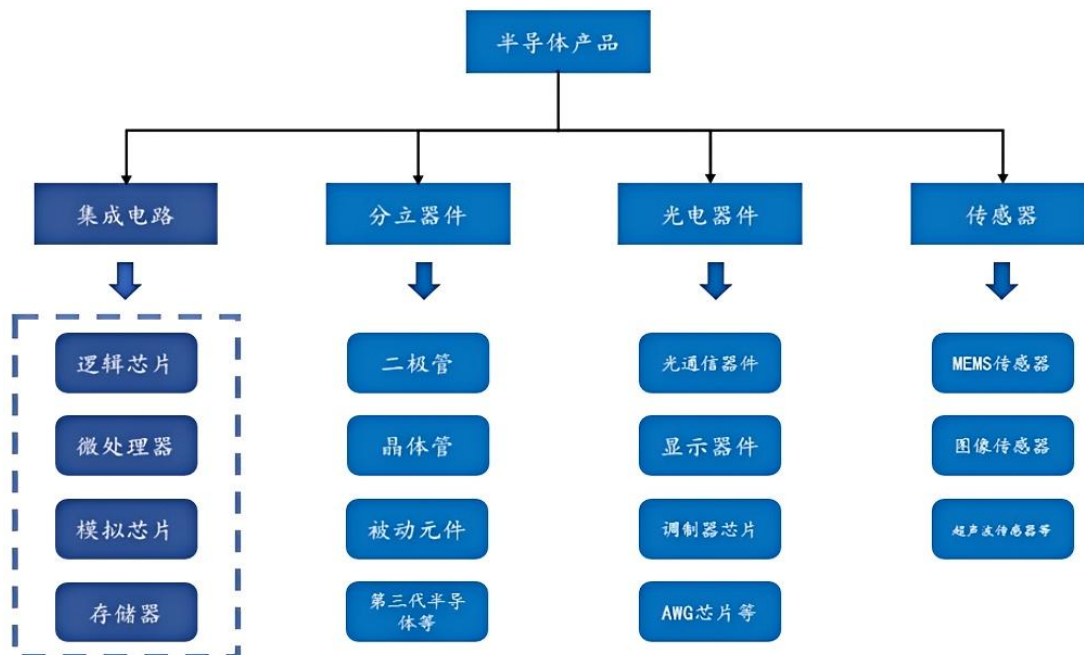
图表 7：AI 大模型训练数据量呈指数级增长



2.3.2 存储墙限制 AI 技术的发展和應用

半导体产品可大致分为集成电路（IntegratedCircuit，IC）、分立电器、光电器件和传感器四大产品类型，根据世界半导体贸易统计组织 WSTS 数据，集成电路占半导体市场份额的约 82%，是半导体产品的核心）。集成电路产品主要为芯片，具体可分为逻辑器件（芯片）、微处理器、模拟器件（芯片）和存储器件（芯片）四种。

图表 8：半导体行业按产品进行分类



存储器件是集成电路的重要分支，.....。

2.3.3 高宽带存储器突破内存带宽与容量瓶颈

.....。

2.3.4 新型存储器是打破存储墙的解决方案之一

.....。

第三章 项目技术所处市场分析

3.1 存储器行业发展情况

3.1.1 行业概述

1、定义

存储器，是计算机系统记忆设备，用来存放程序和数据。计算机中的全部信息，包括输入的原始数据、计算机程序、中间运行结果和最终运行结果都保存在存储器中。它根据控制器指定的位置存入和取出信息。

2、分类

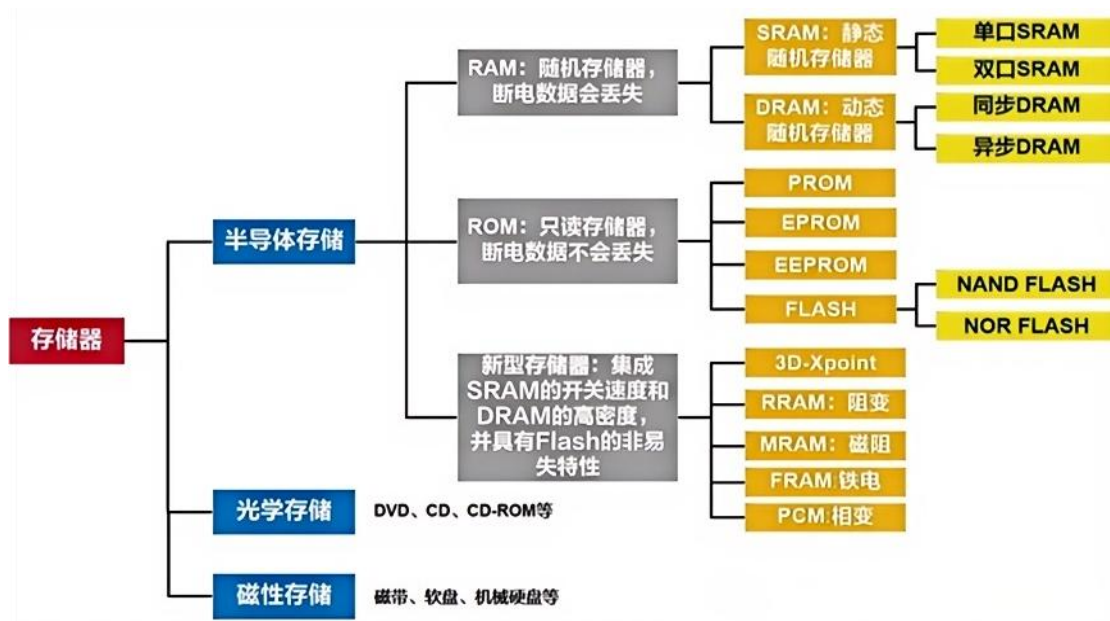
存储器按存储介质不同可分为光学存储、磁性存储和半导体存储。光存储器是指用光学方法从光存储媒体上读取和存储数据的一种设备，一般指光盘机、光带机和光卡机等；磁性存储，是指利用磁能方式存储信息的磁介质设备，其存储与读取过程需要磁性盘片的机械运动，目前广泛应用于 PC 硬盘、移动硬盘等领域；存储芯片，又称为半导体存储器，是指利用电能方式存储信息的半导体介质设备，其存储与读取过程体现为电子的存储或释放，广泛应用于内存、U 盘、消费电子、智能终端、固态存储硬盘等领域。

半导体存储器可以按照断电是否能保存数据分为两类。

第一类易失性存储器，以动态随机存取存储器（DRAM）和静态随机存取存储器（SRAM）为代表，.....。

第二类非易失性存储器，包括以 NOR FLASH 和 NAND FLASH 为代表的传统存储器和四种新型存储器。.....。

图表 10：存储器分类

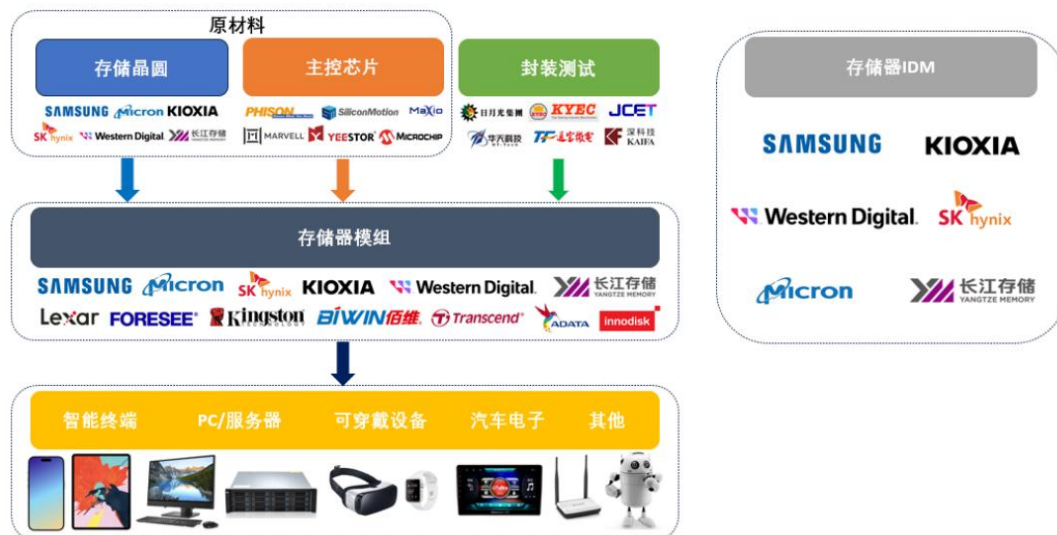


3、发展历程

.....

3.1.2 产业链简介

图表 12：存储器产业链图示



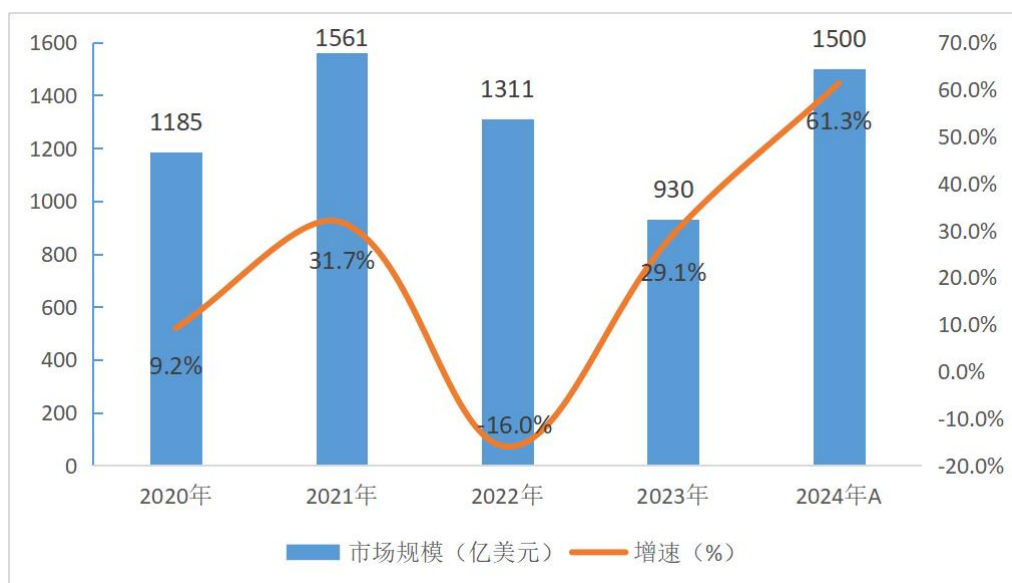
3.1.3 市场发展现状

1、2024 年全球存储器市场进入增长周期

存储器在数字经济发展中占有非常重要的地位，广泛应用于 USB、消费性电子、智慧终端等领域，是应用面最广、市场比例最高的电子基础设施产品之一。

近几年，随着人工智能、智能汽车、大数据等新兴产业快速崛起，数据处理、储存效能重要性快速攀升，存储器市场迎来持续成长并呈现新的发展趋势。受全球经济走势、市场供需关系等因素影响，近来全球存储器销售和单价有所波动，2023年全球存储器市场规模为930亿美元，同比下降29.1%。但随着人工智能大模型等新兴领域对算力需求不断提升，对高效能、高储存、高规格存储器的需求不断增加，2024年存储器价格触底反弹，预计2024年全球存储器市场销售规模将提升61.3%，到1500亿美元。

图表 13：2020-2024 年全球存储器市场规模及变化情况

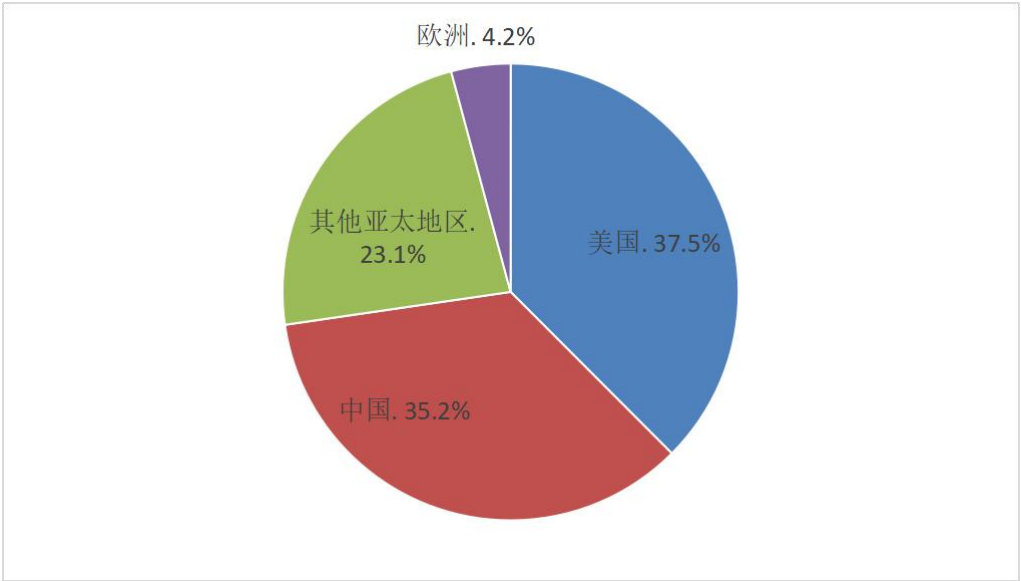


数据来源：世界集成电路协会（WICA）

2、中国是全球存储器第二大市场

.....。2024年，中国存储器市场规模约为528亿美元，市场占比为35.2%，其他亚太地区和欧洲紧随其后。

图表 14：2024 年全球存储器地区市场结构



数据来源：世界集成电路协会（WICA）

3、DRAM 和 NAND Flash 仍为市场主流存储器

.....o

图表 15：2024 年全球存储器产品市场结构

产品类型	占比（%）
DRAM	
NAND Flash	
Nor Flash	
(NV)SRAM/FRAM	
ReRAM等新型	
EEPROM等其他	

数据来源：世界集成电路协会（WICA），Yole

3.1.4 市场竞争格局

目前，全球存储器产业已进入高度垄断的时代，产业呈现明显的寡头竞争格局。全球主要的厂商包括韩国的三星电子、SK 海力士，美国的美光科技、.....

图表 16：2024 年全球存储器市场企业竞争格局

企业名称	市占率（%）
三星电子	
SK海力士	
美光科技	
铠侠集团	
.....	

数据来源：世界集成电路协会（WICA）

3.1.5 下游应用领域

存储器产业的主要下游市场包括手机、个人电脑、服务器等，也是未来物联网、大数据、云计算等新兴领域不可或缺的关键元件。目前存储器第一大应用领域为.....。

3.2 新型存储器行业发展情况

3.2.1 技术发展情况

新型存储器旨在集成 DRAM 的高密度特性和 SRAM 的开关速度，并具有 Flash 的非易失特性。目前新型存储器主要包括相变存储器（PCM）、磁变存储器（MRAM）、阻变存储器（ReRAM）以及铁电存储器（FRAM）。

1、相变存储器

2、磁变存储器

3、阻变存储器

4、铁电存储器

综上，四种新型存储都能在一定程度上有效解决传统存储的“性能墙”和“存储墙”的问题，打破冯·诺依曼体系架构，实现存算一体，消除数据访存带来的延迟和功耗，实现更高的算力和能效比，但是四种新型存储在具体技术特点上有一定差异。

图表 22：主流存储技术与新型存储性能对比

指标	主流存储技术			
	DRAM	SRAM	NAND	NOR
芯片面积				
电压				
读速度				
写速度				
功耗				
持久性				
非易失性				
指标	新型存储技术			
	MRAM	RRAM	FeRAM	PCM
芯片面积				
电压				
读速度				
写速度				
功耗				

持久性				
非易失性				

数据来源：半导体行业观察

3.2.2 商业化发展情况

.....

3.2.3 市场发展规模

1、整体市场发展规模

新型存储器还处于商业化阶段早期，目前市场规模较小。但新型存储器可以广泛用作 CMOS 逻辑芯片上的嵌入式存储器，取代 NOR Flash，后者已达到 28nm 的缩放极限，如今经常被 MRAM 和 ReRAM 取代。

.....。

2、ReRAM 市场发展规模

ReRAM 是目前业内最关注的技术之一，.....。

3.2.4 主要厂商介绍

1、Everspin Technologies

Everspin 科技公司成立于 1996 年，总部位于美国亚利桑那州。Everspin 最初隶属于摩托罗拉（Motorola）的磁阻 RAM（MRAM）部门，并被美国国防高级研究计划局（DARPA）选中，参与其关键技术计划。2004 年，摩托罗拉将其半导体业务剥离，Everspin 于 2008 年独立运营，2016 年在美国纳斯达克上市（股票代码：MRAM），目前已成长为全球领先的 MRAM 以及 STT-MRAM 设计、生产以及销售公司，其产品广泛应用于数据中心、云存储、能源、工业、汽车和运输等领域。

.....

2、昕原半导体

3、.....

3.3 市场发展趋势

3.3.1 市场需求持续扩大

.....。

3.3.2 我国正在承接第三次大规模的集成电路产业转移

.....。

3.3.3 存储器国产化已成为国家战略

.....。

第四章 项目技术及产品方案

4.1 本项目技术介绍

4.1.1 技术简介

4.1.2 技术架构

4.1.3 技术优势

4.1.4 知识产权

截至报告基准日，团队与本项目相关的知识产权共有***项，均为发明专利。

图表 29：项目团队知识产权列表

序号	名称	知识产权类型	知识产权申请号/登记号	状态
1				
2				
3				
4				

4.2 项目产品方案

4.3 产品与知识产权对应关系

第五章 项目运营方案

5.1 交易方案

5.1.1 交易公司

本项目拟采用专利转让的方式，.....。

图表 32：项目公司基本工商信息

公司名称	
------	--

法定代表人	
成立日期	
注册资本	
企业类型	
统一社会信用代码	
营业期限	
注册地址	
经营范围	

5.1.2 交易方式

5.2 交易后公司组织架构

5.2.1 组织架构

5.2.2 劳动定员方案

5.3 公司发展规划

5.3.1 产品研发规划

5.3.2 客户拓展规划

5.4 公司商业模式

5.4.1 业务模式

5.4.2 盈利模式

第六章 项目效益评价

6.1 经济效益评价

6.1.1 评价依据及基础数据说明

（一）遵循的有关依据

- 1、《企业财务通则》；
- 2、《投资项目经济评估指南》；
- 3、业主提供的相关材料；
- 4、市场调研相关资料。

（二）基础数据及说明

- 1、基准日：本报告基准日为 2025 年**月**日；
- 2、计算期：根据项目公司产品规划，预计 2025 年底开始量产，2025 年公司还处于通过一些周期较短、金额较小的项目试用，产品优化，客户案例积累阶段。因此本项目评价的计算期为 2026 年-2035 年，共计 10 年；
- 3、本项目所得税及其他有关税种按税务法规计取，各种税率取值参数见下表：

序号	项目	数值	备注
1	增值税率	6%、13%	产品销项税率 13%；原辅材料进项税率 13%；其他费用 6%
2	城建税	7%	
3	教育费附加	3%	
4	地方教育费附加	2%	
5	所得税率	25%	研发费用 100%加计扣除

- 4、本项目基准收益率为 12%；
- 5、根据北大提供资料，本项目 2025 年-2027 年还将进行资产投入，以进行技术优化和产品迭代，具体投入如下表所示：

图表 37：项目资产投资表

序号	类别	2025年	2026年	2027年
一	设备类固定资产			
1	实验室测试台及测试设备			
2	仪器仪表类工具			
3	电脑及服务器			
二	无形资产			
1	专业软件&工具			
三	流片费			
合计				

6.1.2 项目经营分析

1、营业收入

由于本项目产品处于商业化初期，暂无历史销售数据，因此采用市场规模*市占率的方法进行营收预测。

(1) 市场规模

本项目产品为 ReRAM 新型存储器芯片，根据前文市场规模估算，2026 年-2035 年全球 ReRAM 市场规模将从 9.4 亿美元增长至 48.3 亿美元。按照存储器全球市场结构，估计中国地区市场份额约为 40%，则 2026 年-2035 年中国 ReRAM 市场规模如下表所示：

图表 38：2026 年-2035 年我国 ReRAM 市场规模预测表

	2026 年	2027 年	2028 年	2029 年	2030 年
ReRAM 全球市场规模（亿美元）	9.4	11.2	13.5	16.2	19.4
中国市场占比（%）	40%	40%	40%	40%	40%
中国市场规模（亿元）	26.21	31.45	37.74	45.29	54.34
	2031 年	2032 年	2033 年	2034 年	2035 年
ReRAM 全球市场规模（亿美元）	23.3	27.9	33.5	40.2	48.3
中国市场占比（%）	40%	40%	40%	40%	40%
中国市场规模（亿元）	65.21	78.26	93.91	112.69	135.23

数据来源：Data Bridge Market Research、尚普华泰

注：美元与人民币按照 7:1 的汇率计算

本项目产品.....

（2）市占率

（3）营收估算

则根据市场份额*市占率的逻辑，.....

详见附表：《项目营业收入测算表》。

2、税金测算

税金包括增值税和税金及附加。

A.增值税=销项税额-进项税额（实际抵扣）

销项税额为产品不含税销售收入*销项税率 13%；

进项税包括原辅材料进项税和其他费用进项税，均为当年不含税价值*进项税率，各进项税率参见本章第一节基础数据说明。

B.税金及附加=城市维护建设税+教育费附加+房产税=增值税×城市维护建设税率+增值税×（教育费附加费率+地方教育费附加费率）

各税率参见本章第一节基础数据说明。

经测算，本项目年均缴纳增值税***万元，税金及附加***万元。

3、总成本费用测算

本报告以国内主营产品为 NOR Flash 的厂商兆易创新（603986.SH）、普冉股份（688766）、恒烁股份（688416）作为对标企业，结合项目团队实际情况，对本项目成本数据进行分析。

（1）营业成本

本项目采取 Fabless 业务模式，营业成本主要为代工费用，包括晶圆材料成本、加工成本等。.....。

图表 48：2021-2023 年对标企业存储芯片产品营业成本率

	2021年	2022年	2023年	平均值
兆易创新				
普冉股份				
恒烁股份				

（2）管理费用

管理费用，是指企业日常生产经营中为搞好一般管理业务所必需的费用预算，包括管理及行政人员工资、差旅费、办公室租金、专业服务咨询、水电费、管理相关折旧摊销等。本项目管理费用主要包括管理人员薪资和其他管理费用。

1) 管理人员薪资

2) 其他管理费用

（3）销售费用

1) 销售人员工资

2) 其他销售费用

（3）研发费用

1) 职工薪酬

2) 其他研发费用

（4）利息支出

本项目未来补足短缺资金有三种渠道：1) 股东注资，通过出让股权融资；2) 银行贷款，贷款主要是用来应对销售回款不及时造成的现金流短缺。

经与目标公司沟通，.....。

（5）总成本费用

综上，经测算，本项目年均总成本费用为***万元。详见附表：《项目总成本费用测算表》。

4、项目利润测算

利润测算公式如下：

利润总额=营业收入（不含税）—税金及附加—总成本费用（不含税）；

净利润=利润总额—所得税；

所得税按照 25%计提，应纳所得税额中加计扣除 100%研发费用。

经测算，项目公司年均利润总额***万元，净利润***万元。详见附表：《项目利润测算表》。

5、项目流动资金测算

本报告采用分项详细测算法对本项目流动资金需求量进行测算，根据本项目实际情况和各成本项情况，本项目计算期内共计需要流动资金***万元，详见附表：《项目流动资金测算表》。

6.1.3 经济效益分析

根据项目投资现金流量表，可计算财务净现值 FNPV、财务内部收益率 FIRR、投资回收期 Pt 等各项财务指标。

1、财务净现值 FNPV

财务净现值系指按设定的折现率计算的项目计算期内净现金流量的现值之和，可按下式计算：

$$FNPV = \sum_{t=1}^n (CI - CO)_t (1 + i_c)^{-t}$$

式中：ic——设定的折现率，本项目为 12%。

经计算，所得税后投资财务净现值***万元，大于零。

2、财务内部收益率 FIRR

财务内部收益率（FIRR）系指能使项目在计算期内净现金流量现值累计等于零时的折现率，即 FIRR 作为折现率使下式成立：

$$\sum_{t=1}^n (CI - CO)_t (1 + FIRR)^{-t} = 0$$

式中：

CI——现金流入量；

CO——现金流出量；

(CI-CO) t——第 t 年的净现金流量；

n——计算期。

经计算，所得税后投资财务内部收益率为***%，高于设定的基准收益率 12%。

3、投资回收期 Pt

投资回收期系指以项目的净收益回收项目投资所需要的时间，一般以年为单位。投资回收期可采用下式计算：

$$P_t = T - 1 + \frac{\sum_{i=1}^{T-1} (CI - CO)_i}{(CI - CO)_T}$$

式中：T——各年累计净现金流量首次为正值或零的年数。

经计算，所得税后动态投资回收期为***年，均少于项目计算期。

4、经济效益评价汇总

综上，计算期内本项目年均可实现营业收入***万元，年均可实现利润总额为***万元，年均净利润***万元。所得税后投资财务净现值***万元，大于零；所得税后投资财务内部收益率为***%，高于项目基准收益率 10%；所得税后动态投资回收期为***年，少于计算期。本项目具有财务可行性。

图表 58：项目财务指标汇总表

序号	指标	单位	指标	备注
1	资产投入	万元		
2	销售收入	万元		10年平均，含税
3	总成本费用	万元		10年平均，含税
4	利润总额	万元		10年平均
5	净利润	万元		10年平均
6	上缴税金	万元		10年平均
6.1	上缴销售税金及附加	万元		10年平均
6.2	年上缴增值税	万元		10年平均
7	财务内部收益率	%		税后
8	静态投资回收期	年		不含建设期，税后
9	动态投资回收期	年		不含建设期，税后
10	财务净现值	万元		税后
11	净利润率	%		10年平均
12	盈亏平衡点	%		

6.2 社会效益评价

作为一种新兴的非易失性存储技术，ReRAM 在性能、功耗、成本和应用场景等方面具有独特的优势，其发展将对多个领域产生深远影响。

6.2.1 推动技术创新与产业升级

.....。

6.2.2 提升能源效率，助力绿色低碳发展

.....○

6.2.3 提升国家科技实力与战略安全

.....○

第七章 项目风险分析及防范措施

7.1 技术研发不及预期风险及防范措施

7.1.1 风险识别

ReRAM 技术虽然作为下一代内存解决方案很有前途,但仍面临着某些挑战,这些挑战阻碍了其广泛采用。主要问题包括:.....。

7.1.2 防范措施

7.2 吸引人才与保持创新能力的风险

7.2.1 风险识别

7.2.2 防范措施

7.3 市场规模增长不及预期风险及防范措施

7.3.1 市场规模增长不及预期风险识别

7.3.2 防范措施

7.4 市场竞争风险及防范措施

7.4.1 市场竞争风险识别

7.4.2 防范措施

7.5 供应商风险及防范措施

7.5.1 风险识别

7.5.2 防范措施

第八章 项目可行性研究结论及建议

8.1 可行性研究结论

8.1.1 符合政策的可行性结论

8.1.2 技术方案的可行性结论

8.1.3 市场规模的可行性结论

8.1.4 经济效益的可行性分析

8.1.5 风险分析的可行性结论

8.2 可行性研究建议

尚普华泰咨询各地联系方式

北京总部：北京市海淀区苏州街 3 号大恒科技大厦 6 层

联系电话：010-82885739 13671328314

河北分公司：河北省石家庄市长安区广安大街 16 号美东国际 D 座 6 层

联系电话：0311-86062302 15130178036

山东分公司：山东省济南市历下区东环国际广场 A 座 11 层

联系电话：0531-61320360 13678812883

天津分公司：天津市和平区南京路 189 号津汇广场二座 29 层

联系电话：022-87079220 13920548076

江苏分公司：江苏省南京市秦淮区汉中路 169 号金丝利国际大厦 13 层

联系电话：025-58864675 18551863396

上海分公司：上海市浦东新区商城路 800 号斯米克大厦 6 层

联系电话：021-64023562 18818293683

陕西分公司：陕西省西安市高新区沣惠南路 16 号泰华金贸国际第 7 幢 1
单元 12 层

联系电话：029-63365628 15114808752

广东分公司：广东省广州市天河区珠江西路 21 号粤海金融中心 12 楼

联系电话：020-84593416 13527831869

深圳分公司：深圳市福田区深南大道 2008 号凤凰大厦 2 栋 26 层

联系电话：0755-23480530 15818652049

重庆分公司：重庆市渝中区民族路 188 号环球金融中心 12 层

联系电话：023-67130700 18581383953

浙江分公司：浙江省杭州市上城区西湖大道一号外海西湖国贸大厦 15 楼

联系电话：0571-87215836 13003685326

湖北分公司：湖北省武汉市汉口中山大道 888 号平安大厦 21 层

联系电话：027-84738946 18163306806